

ともに歩む、その先の革新へ



2025年度通期 決算説明会

イビデン株式会社(4062)

2026年5月12日



このプレゼンテーション資料には、2026年5月11日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。

2025年度 実績

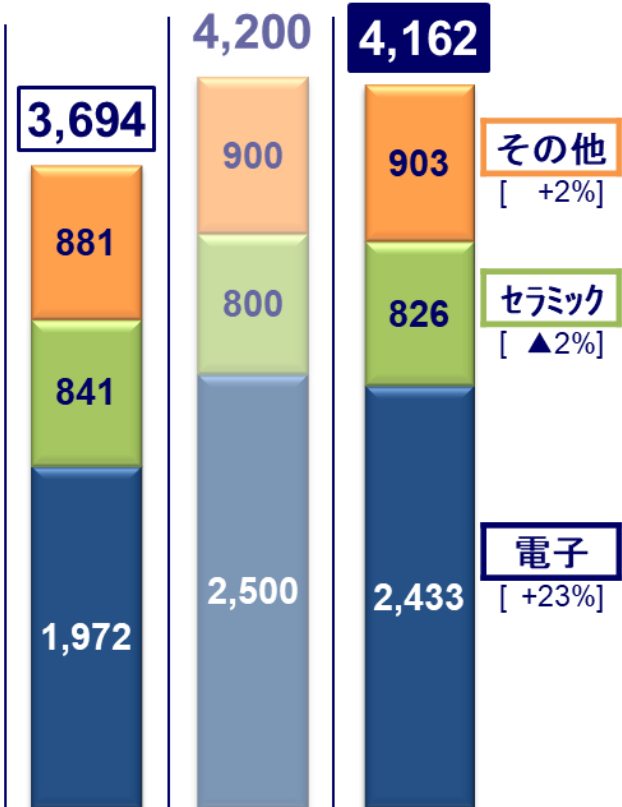
2025年度(通期) 売上高・営業利益・純利益

売上高

[]は
24年度比

(億円)

24年度比
+13%



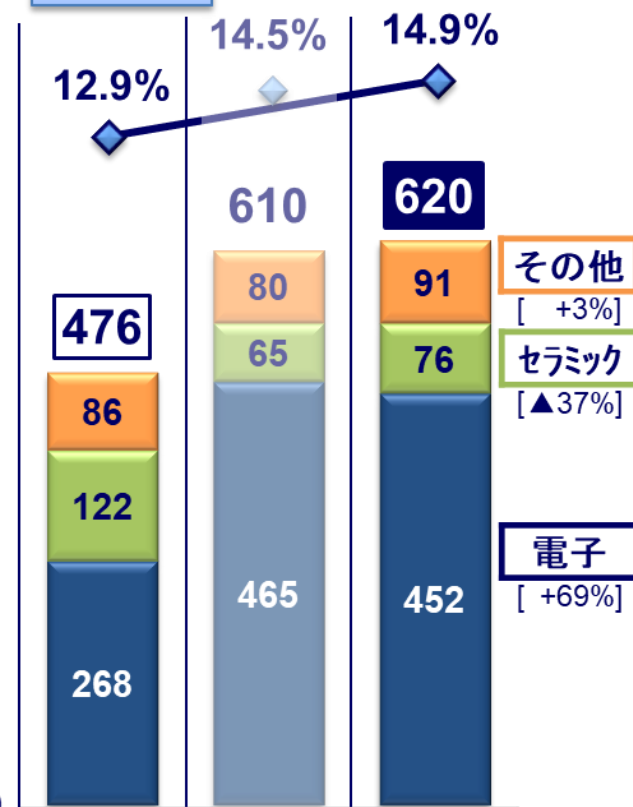
営業利益

[]は
24年度比

(億円)

24年度比
+30%

営業利益率

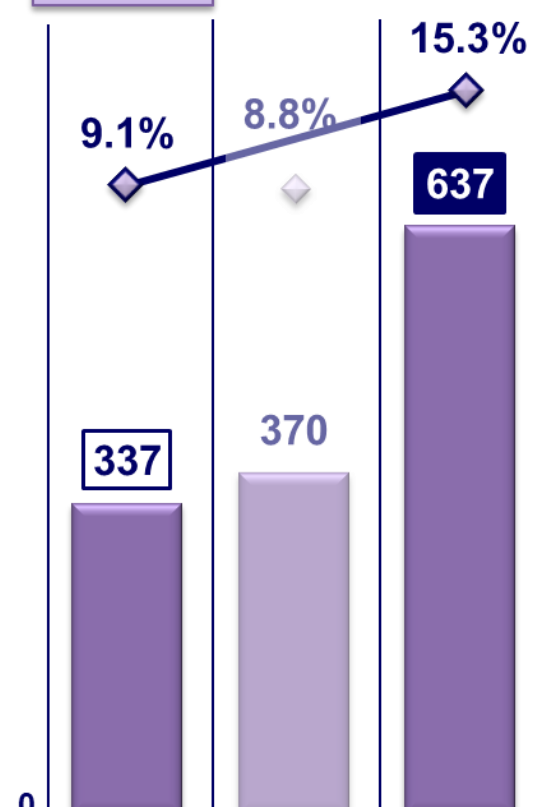


純利益

(億円)

24年度比
+89%

純利益率



項目	実績 24年度	2/3開示 25年度	実績 25年度	為替(ドル)	為替(ユーロ)
売上高	3,694	4,200	4,162		
営業利益	476	610	620		
純利益	337	370	637		
営業利益率	12.9%	14.5%	14.9%		
純利益率	9.1%	8.8%	15.3%		
為替(ドル)	152	148	149		
為替(ユーロ)	162	171	172		

[ご参考]

政策投資株売却益
(税引後換算)

(単位:億円)

政策投資株売却益	171	-	345
----------	-----	---	-----

2026年度以降 業績見通し

【注記】

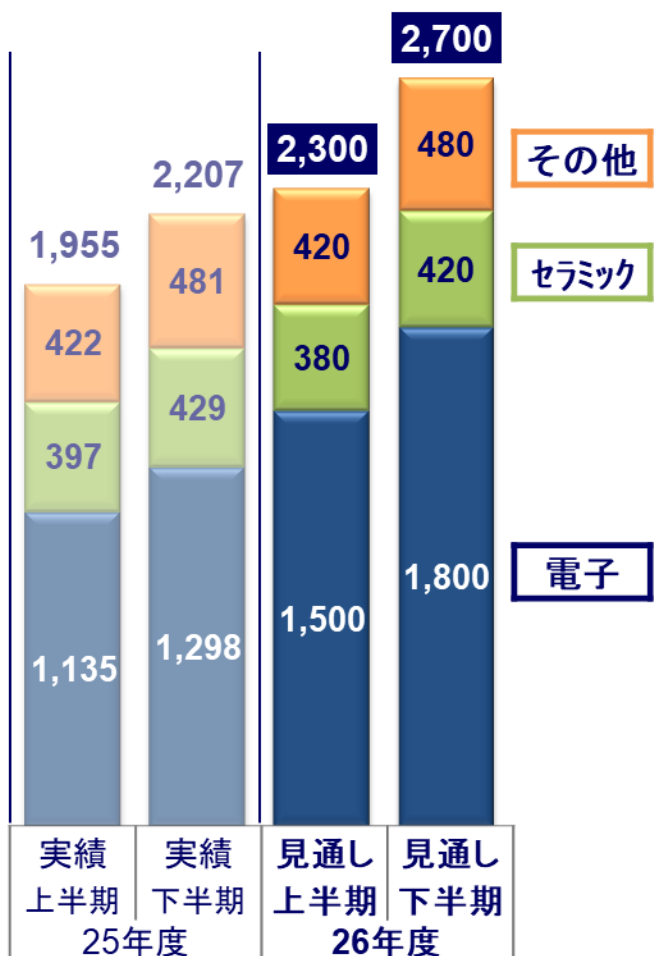
中東リスクについては、特定できた範囲においては影響は軽微と見込んでおります。但し、状況が極めて不透明であり、現時点では業績予想に織り込んでおりません。

2026年度(半期) 売上高・営業利益・純利益 見通し



売上高

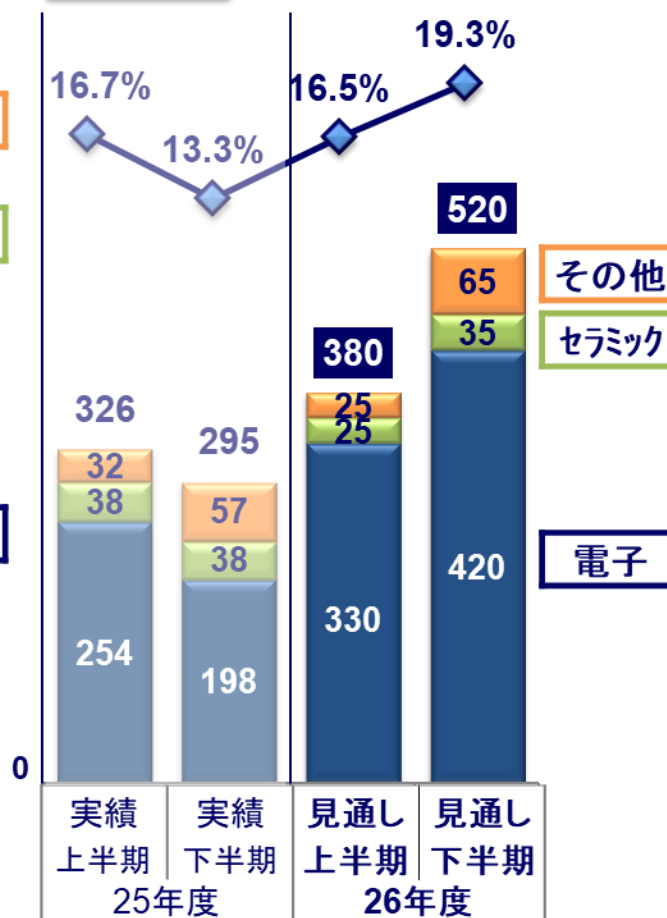
(億円)



営業利益

(億円)

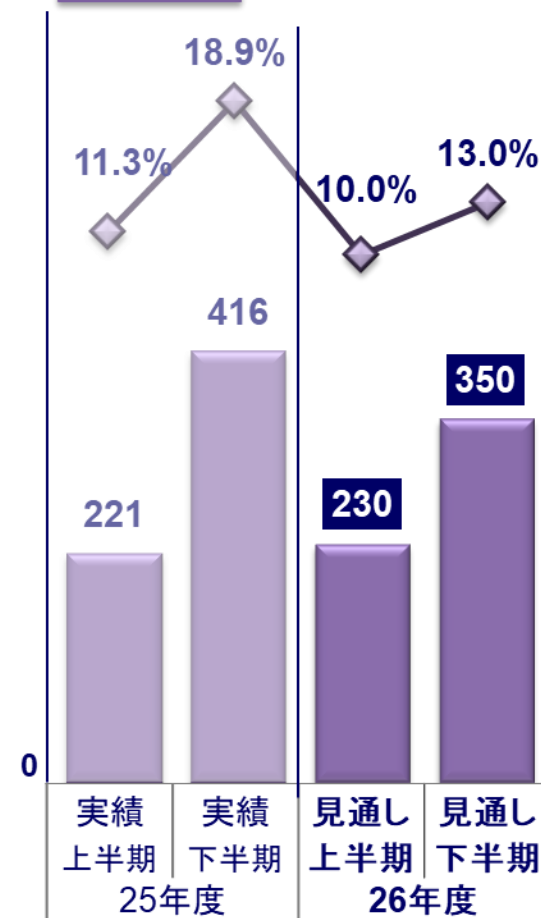
営業利益率



純利益

(億円)

純利益率



145	153	150	150	為替(ドル)
165	178	180	180	為替(ユーロ)

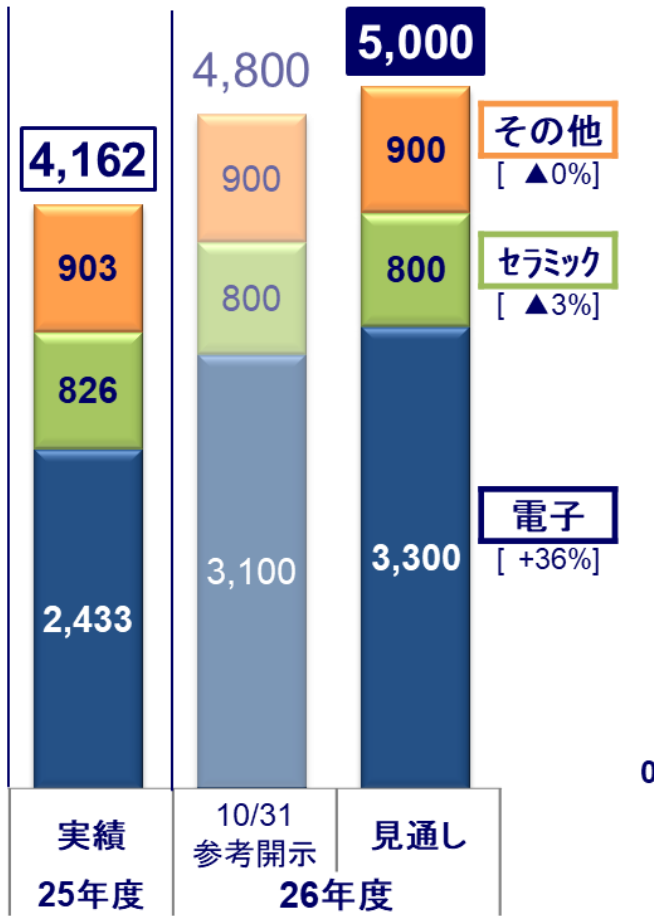
2026年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 見通し

売上高

[]は
25年度比

25年度比
+20%

(億円)



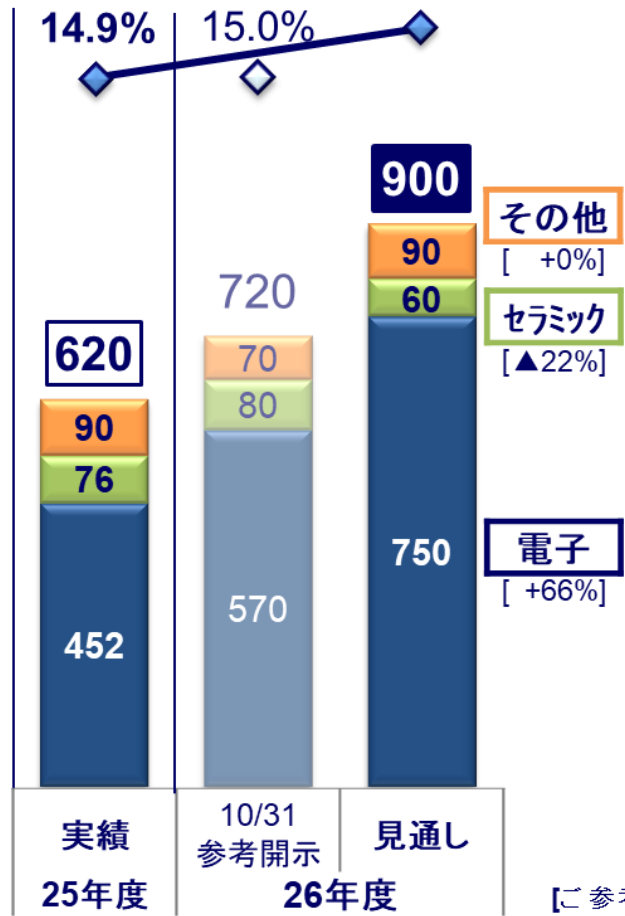
営業利益

[]は
25年度比

25年度比
+45%

(億円)

営業利益率

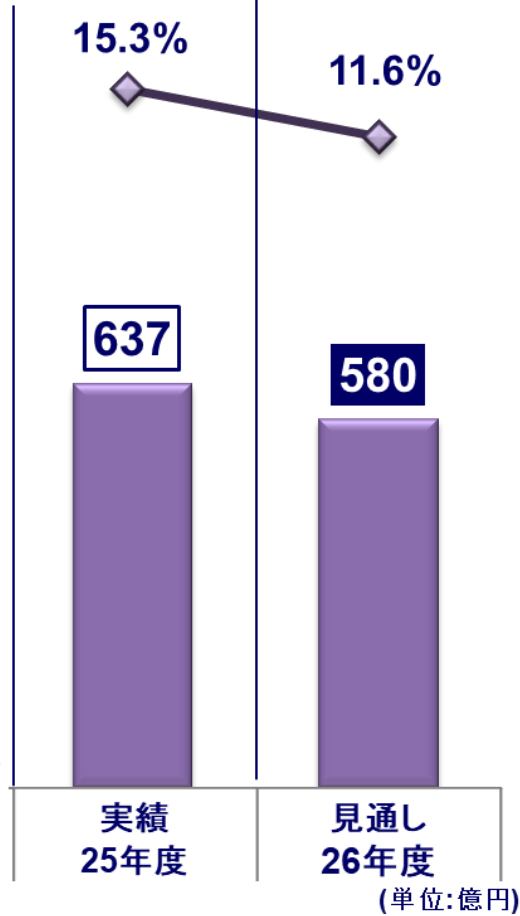


純利益

25年度比
▲9%

(億円)

純利益率



[ご参考]

政策投資株売却益
(税引後換算)

項目	実績 25年度	10/31 参考開示 26年度	見通し 26年度
為替(ドル)	149	(145)	150
為替(ユーロ)	172	(165)	180

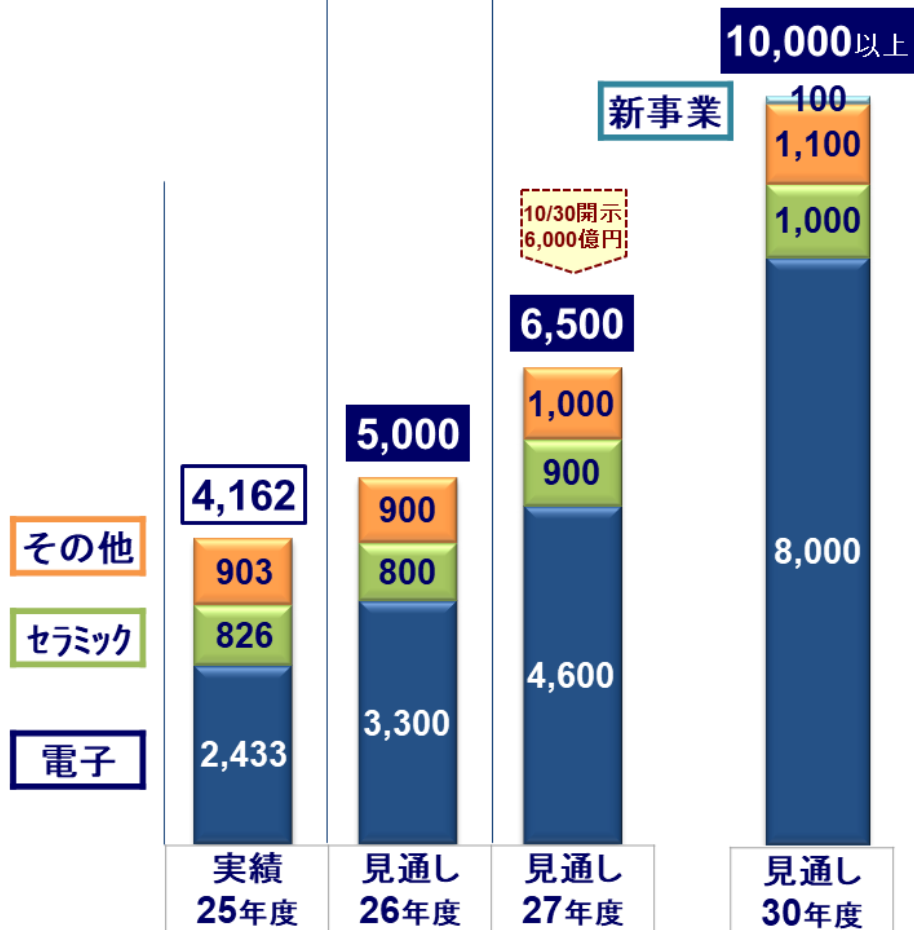
項目	実績 25年度	見通し 26年度
政策投資株売却益 (税引後換算)	345	-

中期業績見通し

- 現中期経営計画の最終年度である2027年度の業績目標を上方修正する
- 電子事業を軸に、2030年度に「売上1兆円・営業利益3,000億円(営利率30%)」を目指す

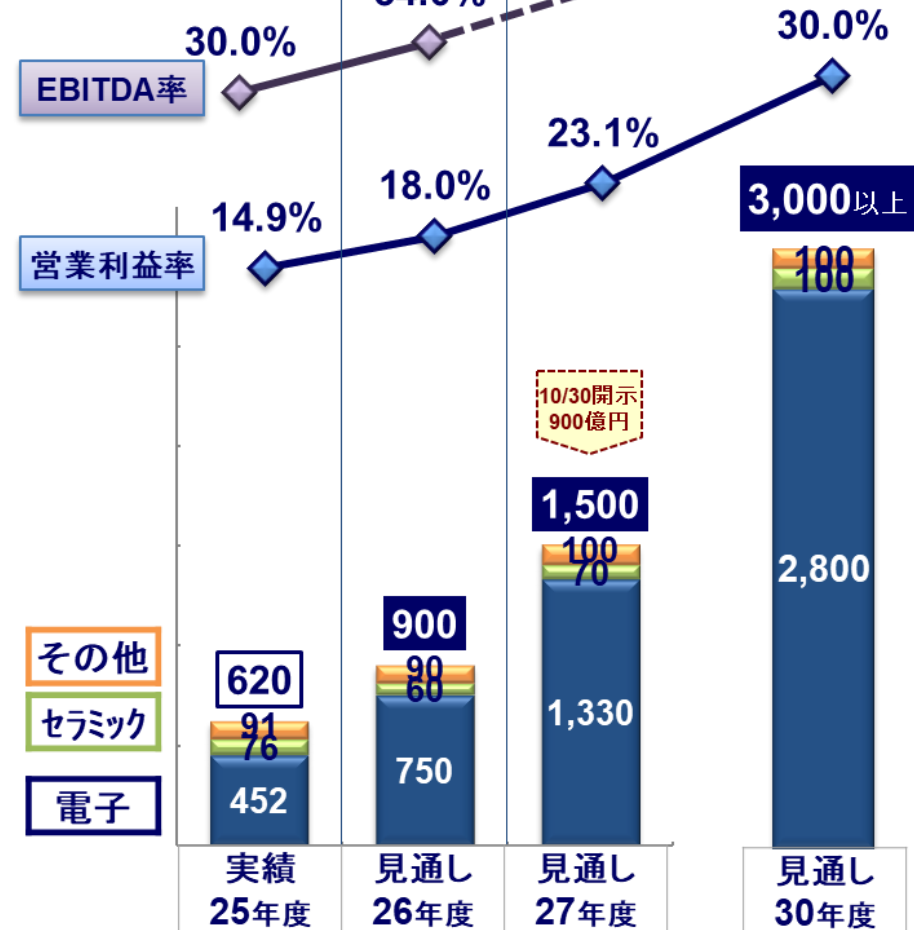
売上高

(億円)



営業利益

(億円)



資金配分と設備投資額

- 政策保有株式の縮減目標は25年度で前倒し達成済(23年度末時価ベースでの縮減率 81.2%)
- 成長投資は、前受金を含む営業CF以内を基本とし、業績変化に強い財務体質を構築する
- 株主還元は、配当性向20%を目安に、収益水準・財務指標・株価を総合的に判断して実施する

キャッシュアロケーション

26~28年度累計



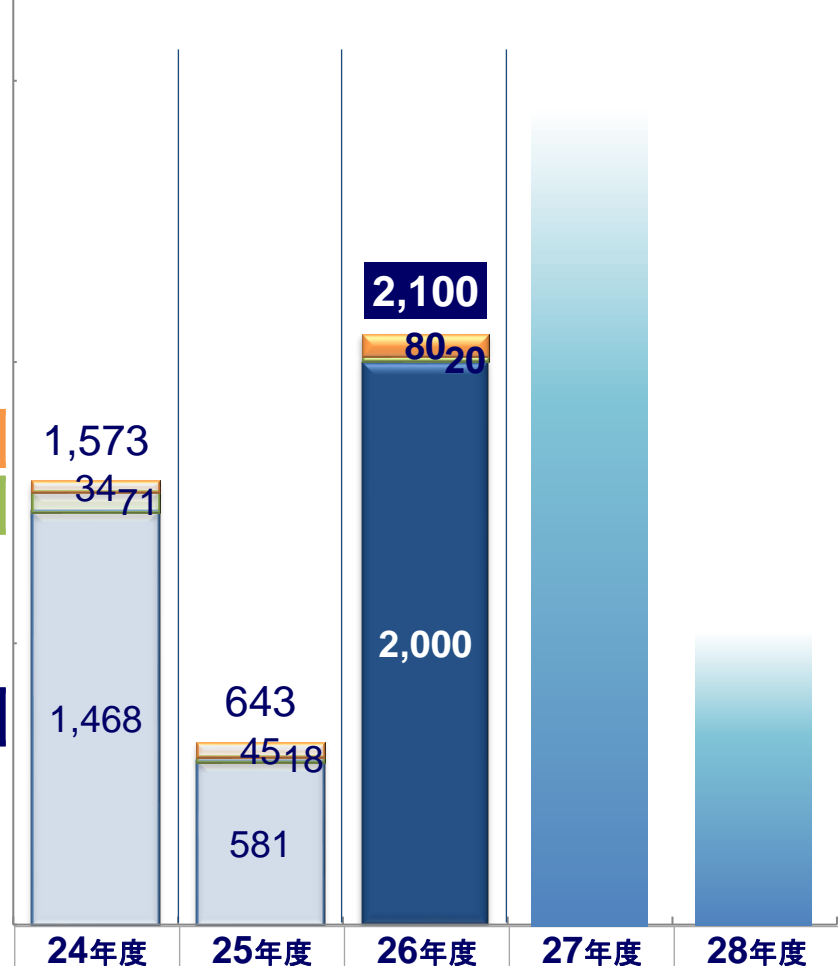
設備投資額

(億円)

その他

セラミック

電子



市場見通しと 当社事業展望

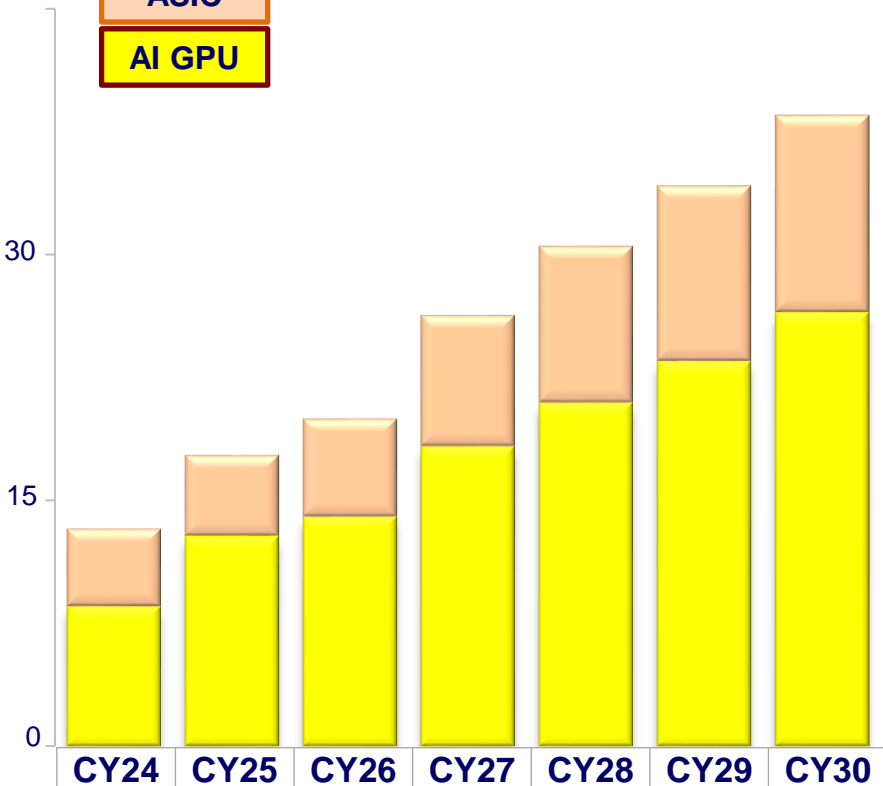
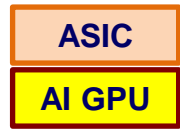
電子市場の動向と変化

- 需要拡大が継続するAI GPUに加え、AI推論に特化したASIC需要が急速に増加する見通し
- AIの学習から推論へのシフトに伴い、汎用サーバー向けのCPU需要が増加する見通し
- サーバー間およびデータセンター間の高速伝送を実現するため、スイッチICの高性能化が見込まれる

AI GPU/ASIC市場

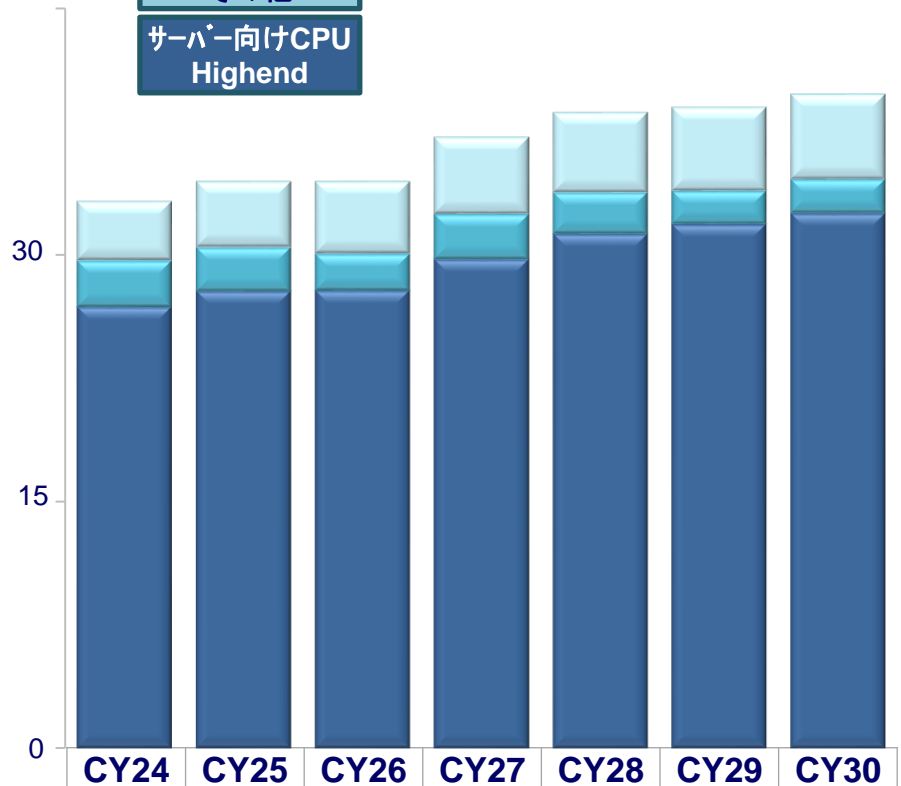
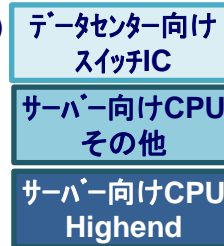
(百万個)

(外部調査会社の情報を基に推定)



CPUその他市場

(百万個)



ICパッケージ基板の需要見通しと当社能増計画

- ICパッケージ基板の大型化・高多層化に伴い、SAP総需要は業界の供給能力を上回る見通し
- 当社は、最先端半導体向けを中心とした能増により、ハイエンド市場でのトップシェアを維持する

SAP*総需要(面積)

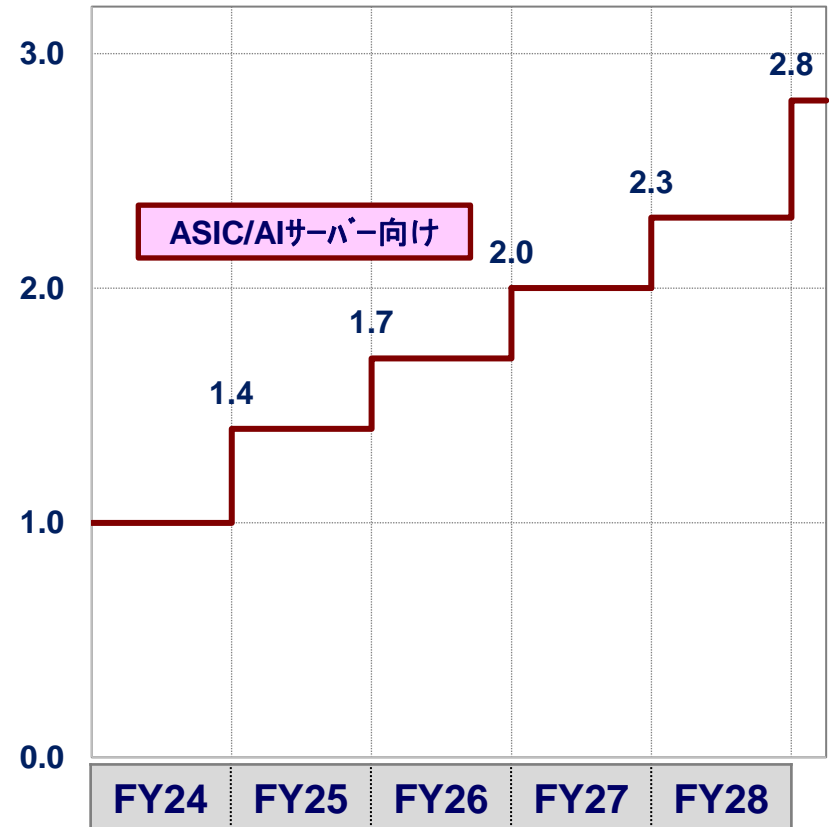
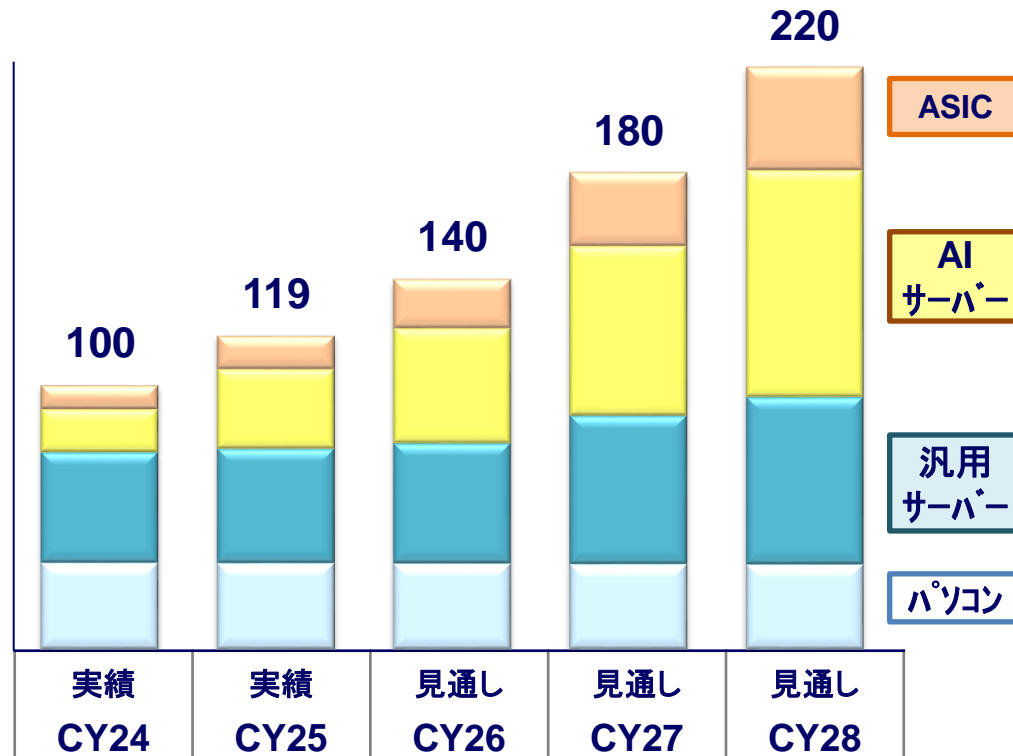
※SAP : Semi Additive Process
 ※24年を「100」として指数化

当社能増計画(指数)

■ AIサーバー向け基板の生産負荷(SAP換算)

(顧客情報等を基に推定)

	24年	26年	28年
生産負荷	1.0 (基準)	x 1.8倍	x 2.5倍



電子事業の成長に向けた設備投資

- 2/3に発表した総額5,000億円の設備投資を計画通り遂行し、市場・顧客ニーズに応じていく
- 既存工場の生産能力を最大且つ柔軟に活用しつつ、次の投資・生産戦略の検討を進める

河間事業場

項目	内容
投資額	約2,200億円 (Cell6)
稼働時期	2027年度より順次稼働し、量産開始
生産品目	AI ASIC向け 高機能ICパッケージ基板



大野事業場

項目	内容
投資額	約2,800億円 (Cell8の残り1/2)
稼働時期	2027年度より順次稼働し、量産開始
生産品目	AI GPU向け 高機能ICパッケージ基板



ICパッケージ基板の進化と開発

- 最先端製品では大型化・高多層化に加えて部品内蔵が進展し、付加価値増加が見込まれる
- 引き続き全方位で必要となる要素技術を先行開発し、顧客の最先端半導体開発を支える

	CY25	CY26	CY28	CY30~
Dieサイズ(レチクル)	3.5	5.0	7.5	9 <
基板サイズ	80 x 80	90 x 90	110 x 110	130 x 130 <
SAP	9-X-9	10-X-10	12-X-12	14-X-14
構造(2.5D)				
光電変換				

セラミック市場の動向と変化

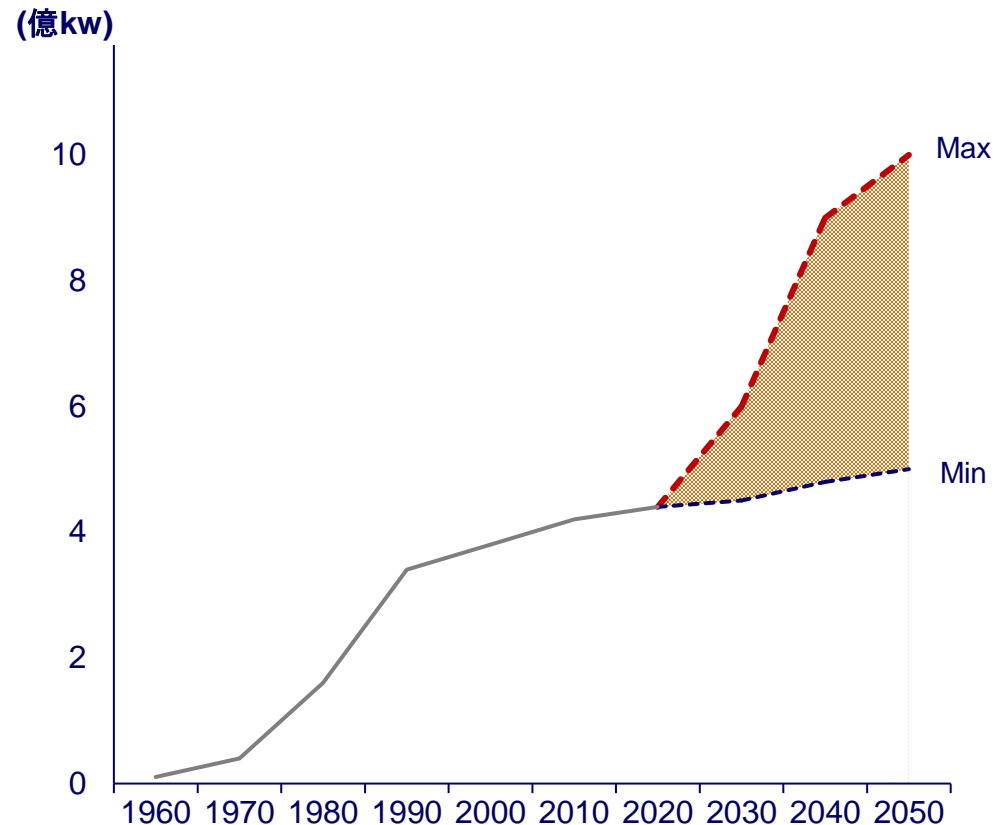
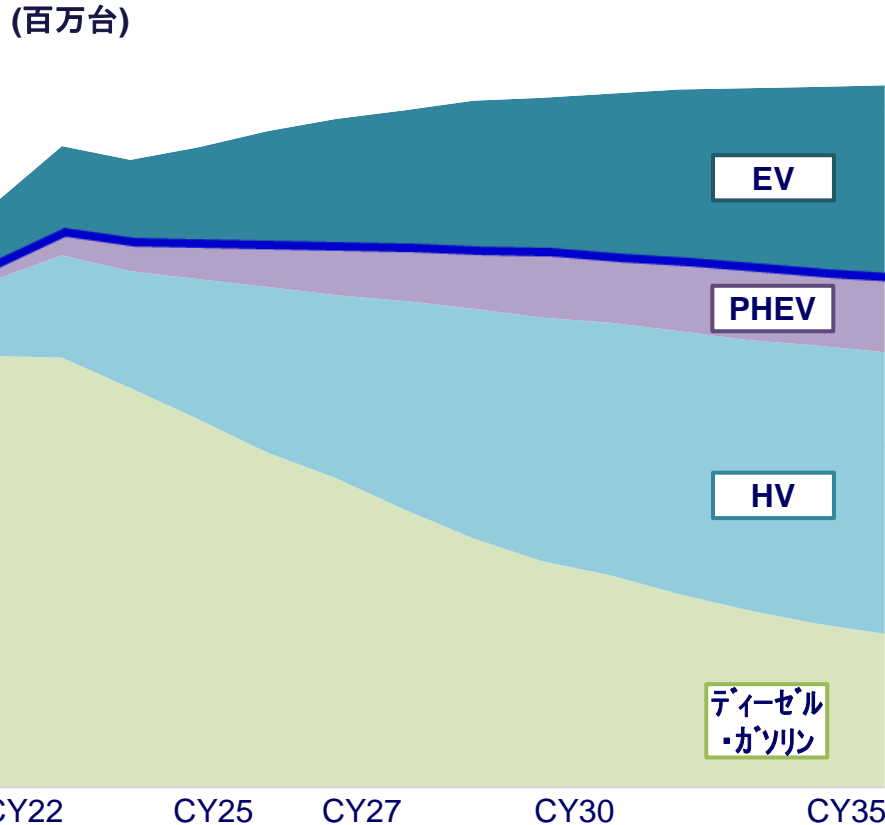
- 内燃機関向け製品は継続の見通し、引き続きPHEV・新興国の建機/農機需要を取り込む
- EV向け製品は、海外市場を含む採用実績の積み上げによって事業拡大を狙う
- グラファイト製品は、DC向け需要の増加を背景に成長する原子力分野(北米)で事業拡大を狙う

パワートレイン市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

原子力発電

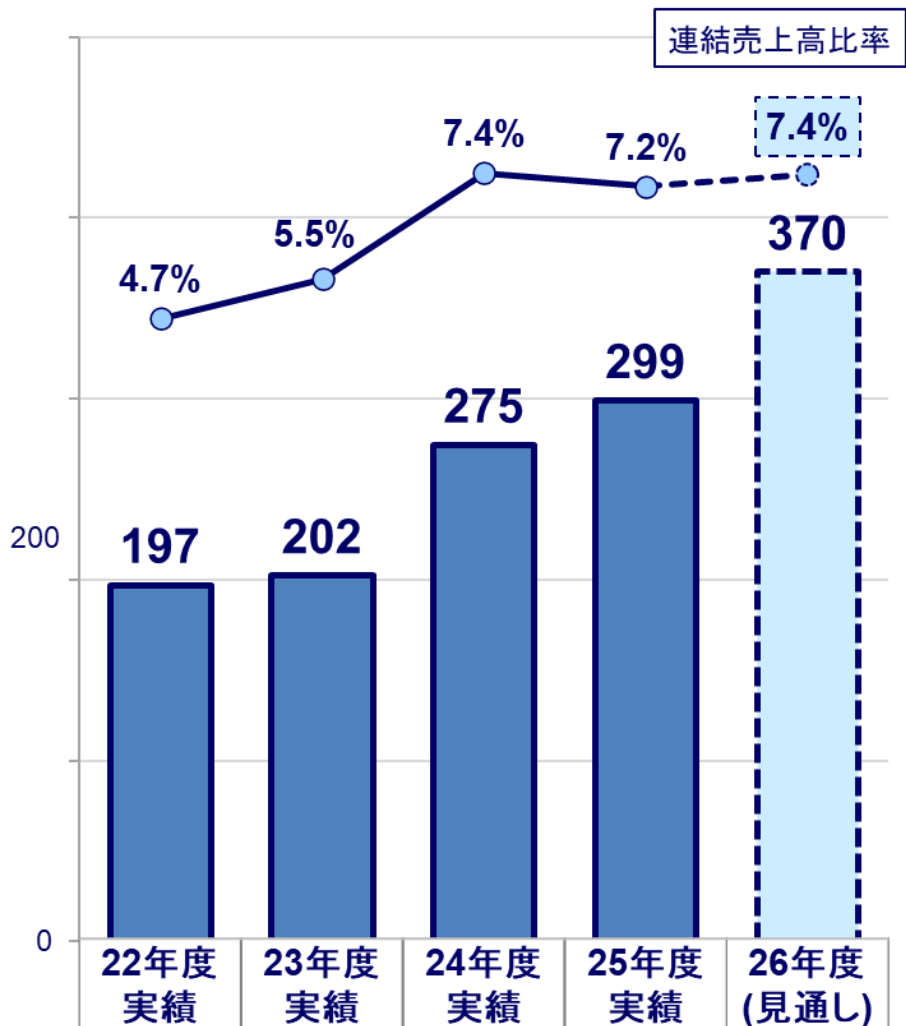
(外部調査会社の情報を基に推定)



次の成長に向けた研究開発活動

□ 自社開発に加えて、産学官連携のオープンイノベーション・VCも活用し、新製品の早期事業化を目指す

研究開発費の推移(実績・計画)



当社の研究開発領域

NEV 領域

- NEV向け部材
 - ・ LiB安全部材
 - ・ 耐熱断熱材
 - ・ 耐熱絶縁部材



EV車載蓄電池

特殊 基板 領域

- “パワーモジュールおよびロボティクス向け領域”の研究開発



新領域

- 植物活性化材 (LEAFENERGY)
- CO₂固定化技術



+

オープンイノベーションを活用した開発活動
(シナジー効果がある産学官と連携し新規事業を創出)

株主還元

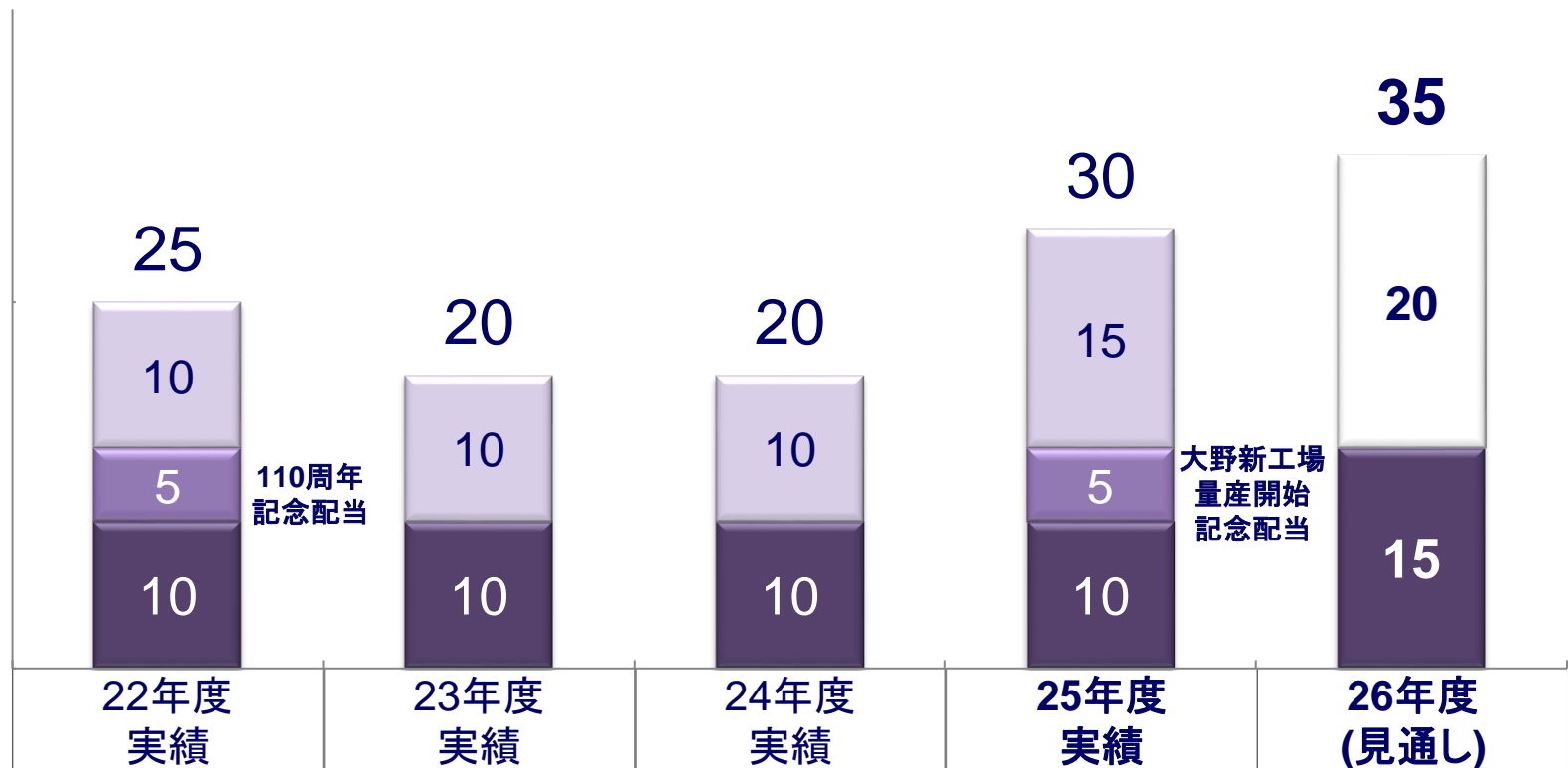
- 25年度の期末配当は、24年度の期末配当対比で5円増配となる15円/株を予定
- 26年度の通期配当予想額は、25年度対比で5円増配となる35円/株を予定(上期15円・期末20円)
- 株主に対する利益還元は、成長投資及び財務規律とのバランスを考慮しつつ、配当性向20%を目安とし、累進配当とする方針(30年度まで)

一株当たり配当金

(円)

期末
配当金

中間
配当金



ともに歩む、その先の革新へ

